

高電壓/電流卡盤

用於晶圓測試和實驗分析

- 電壓可高達一萬伏/電流達600A，可應用於MOSFET和IGBT等
- RDson數據保持精確和一致
- 薄晶圓安全裝載
- 超低漏電流，最低可到5 pA
- 可用於搭配不同廠牌的針測機，適用性廣，且可依不同應用只換卡盤頂盤，節省量產成本支出



產品介紹

- ✓ 可供選擇的卡盤從簡單的1.5千伏同軸連接到10千伏同軸連接，甚至3千伏三軸連接，且最大電流可達600安培，同時可以滿足從 -65°C 到 +300°C 不等的測試溫度需求。
- ✓ 該卡盤可以保證在高達一萬伏的高壓下超低漏電、避免擊穿。
- ✓ 提供獨特的針測機載物台定製化服務，讓處理薄晶圓、Taiko晶圓等特殊形態晶圓變成可能。
- ✓ 客戶不僅可以根據自己的需要選擇卡盤的類型，還可以選擇「僅更換卡盤頂盤」的服務，以應對測試需求不斷升級的半導體市場。

產品種類

同軸連接

電壓最大可至10千伏
在3千伏電壓時漏電低至1,2 nA

三軸連接

電壓最大可至3千伏
在3千伏電壓時漏電低至50 pA

超低噪音

電壓最大可至3千伏
在3千伏電壓時漏電低至5 pA

